



2020年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2019年9月27日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 2019年10月15日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年5月期第1四半期の業績(2019年6月1日～2019年8月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年5月期第1四半期	23,806	3.4	1,585	6.0	1,505	1.5	1,036	1.9
2019年5月期第1四半期	23,032	42.2	1,495	24.4	1,483	24.4	1,017	24.6

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年5月期第1四半期	32.26	—
2019年5月期第1四半期	31.68	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年5月期第1四半期	95,019	61,212	64.4
2019年5月期	97,390	60,665	62.3

(参考)自己資本 2020年5月期第1四半期 61,212百万円 2019年5月期 60,665百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年5月期	—	15.00	—	15.00	30.00
2020年5月期	—	—	—	—	—
2020年5月期(予想)	—	16.00	—	16.00	32.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2020年5月期の業績予想(2019年6月1日～2020年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	93,000	△2.3	5,750	1.8	5,550	1.3	3,850	1.1	119.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年5月期1Q	35,497,183株	2019年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2020年5月期1Q	3,370,507株	2019年5月期	3,370,507株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2020年5月期1Q	32,126,676株	2019年5月期1Q	32,127,732株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復が継続いたしました。

半導体シリコンウエハーの生産は半導体市場の在庫調整の影響を受けました。また、当社の主要なユーザーである半導体・電子部品関連各社の設備投資には、概ね慎重な姿勢が見られました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は238億6百万円と前年同四半期比3.4%の増収となり、営業利益は15億8千5百万円(前年同四半期比6.0%増)、経常利益は15億5百万円(同1.5%増)、四半期純利益は10億3千6百万円(同1.9%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、300mmウエハー(再生ウエハーを含む)を中心に生産は全体として堅調に推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、その他の取扱商品において増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して23億7千万円減少し、950億1千9百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により29億1千8百万円減少し、338億6百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加5億5千4百万円等により、612億1千2百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、景気は引き続き緩やかに回復していくことが期待されるものの、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響などが懸念され、わが国経済は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

そうした中で半導体業界におきましては、足元では在庫調整の影響を受けているものの、中長期的には、人工知能(AI)や次世代通信規格(5G)の普及などに伴う半導体需要の増加が見込まれております。

このような経営環境のもと、当社といたしましては、より高精度かつ生産性の高い加工プロセスを確立し競争力の強化を図るとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

なお、未定としておりました2020年5月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高930億円、営業利益57億5千万円、経常利益55億5千万円、当期純利益38億5千万円を見込んでおります。

また、年間配当金につきましては、前期に比べ2円の増配となる1株当たり32円とし、中間配当金及び期末配当金をそれぞれ1株当たり16円とする予定であります。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年5月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,415	13,712
受取手形及び売掛金	26,452	29,089
商品及び製品	2,587	361
仕掛品	785	1,129
原材料及び貯蔵品	2,039	2,152
その他	1,102	644
貸倒引当金	△6	△5
流動資産合計	50,376	47,085
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	21,823	22,872
機械及び装置(純額)	17,067	17,744
その他(純額)	4,930	4,267
有形固定資産合計	43,822	44,885
無形固定資産	593	600
投資その他の資産		
その他	2,603	2,454
貸倒引当金	△5	△5
投資その他の資産合計	2,598	2,448
固定資産合計	47,013	47,933
資産合計	97,390	95,019
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,755	19,342
短期借入金	100	100
未払金	10,893	10,393
未払法人税等	1,204	438
引当金	150	517
その他	2,027	1,468
流動負債合計	35,131	32,261
固定負債		
長期借入金	100	75
退職給付引当金	1,327	1,304
その他	165	165
固定負債合計	1,593	1,545
負債合計	36,724	33,806

(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年5月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	27,769	28,324
自己株式	△4,766	△4,766
株主資本合計	60,605	61,160
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	58	38
繰延ヘッジ損益	1	14
評価・換算差額等合計	59	52
純資産合計	60,665	61,212
負債純資産合計	97,390	95,019

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)
売上高	23,032	23,806
売上原価	20,614	20,941
売上総利益	2,418	2,864
販売費及び一般管理費	922	1,279
営業利益	1,495	1,585
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	5	7
為替差益	7	—
その他	14	6
営業外収益合計	28	15
営業外費用		
支払利息	0	0
固定資産除売却損	5	80
その他	35	14
営業外費用合計	41	95
経常利益	1,483	1,505
税引前四半期純利益	1,483	1,505
法人税、住民税及び事業税	772	364
法人税等調整額	△306	104
法人税等合計	465	468
四半期純利益	1,017	1,036

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第1四半期累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	10,871	12,160	—	23,032	—	23,032
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	2,330	2,332	△2,332	—
合計	10,873	12,160	2,330	25,364	△2,332	23,032

当第1四半期累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	11,651	12,154	—	23,806	—	23,806
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	48	710	759	△759	—
合計	11,652	12,202	710	24,565	△759	23,806